

附件 1

《北京市重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》

序号	材料名称	性能要求
先进基础和关键战略材料		
一	电子信息材料	
1	集成电路用高品质铁镍合金带材	厚度: 0.05–0.25mm; 宽度: 20–650mm; Rm: 580–720MPa, A: 5–20%, HV180–220; Ra ≤ 0.12 μm, Rmax ≤ 1.10 μm; 波浪 < 0.1mm/m, 横向弯曲 ≤ 0.15mm; 悬垂翘曲: ≤ 10mm/m; 卷重: 60–200Kg。
2	电子级镍级合金极薄带与超薄带	金属箔材厚度 0.010–0.10mm, 宽度 100–600mm, 不平度优于 6mm/m, 边/中浪优于 0.015, 表面粗糙度优于 0.3 μm, 20–300°C 平均热膨胀系数为 0–5.5 × 10 ⁻⁶ / °C。
3	高频微波、高密度封装覆铜板、极薄铜箔	(1) 高频微波覆铜板: 介电常数 (DK) 3.50 ± 0.05 (10GHz), 高频损耗 < 0.004 (10GHz), 玻璃化温度 > 200°C, 剥离强度 > 0.8N/mm; (2) 高密度覆铜板: 玻璃化温度 > 250°C, 平面膨胀系数 < 28ppm/°C; (3) 极薄铜箔: 厚度 ≤ 6 μm, 单位面积重量 50–55g/m ² , 抗拉强度 ≥ 400MPa, 延伸率 ≥ 3.0%, 粗糙度: 光面 ≤ 0.543 μm, 毛面 ≤ 3.0 μm, 抗高温氧化性: 恒温 (140°C/15min) 无氧化变色; (4) 高频高速基板用压延铜箔: 典型厚度及精度 $12 \pm 0.5 \mu m$, 单位面积质量 100–111g/m ² , 宽度及精度 520 ± 1.5 mm, 抗拉强度 (室温) ≥ 460MPa, 抗拉强度 (180°C × 30min) ≤ 210MPa, 延伸率 (室温) ≥ 0.7%, 延伸率 (180°C × 30min) ≥ 4%, 空气中 200°C × 60min 无氧化, 粗糙度 M 面 (Rz) ≤ 1.3 μm, 剥离强度 ≥ 0.7N/mm; 超低轮廓度压延铜箔: 表面粗糙度 Rz ≤ 0.9 μm, 抗剥离强度 ≥ 0.8N/mm, 滑动弯曲性能 ≥ 15 万次, FCCL 的 180° 弯折试验 ≥ 5 次。
4	高性能铜镍锡合金带箔材	(1) Cu9Ni6Sn 合金带箔材: 厚度 0.05–0.08mm, 公差 ± 0.007mm, 抗拉强度 540–600MPa, 屈服强度 490–550MPa, 硬度 HV > 170, 延伸率 > 6%, 导电率 > 12%IACS, 公差 ± 0.003mm; 厚度 0.1–0.2mm, 抗拉强度 > 1000MPa, 屈服强度 > 950MPa, 硬度 HV > 310, 延伸率 > 4%, 导电率 ≥ 12%IACS; (2) Cu15Ni8Sn 合金箔材: 厚度 0.04–0.06mm, 公差 ± 0.002mm, 抗拉强度 > 1300MPa, 屈服强度 > 1250MPa, 硬度 HV > 410, 延伸率 ≥ 1%, 导电率 ≥ 8%IACS, 100°C/100h 条件应力松弛 ≤ 2%;

序号	材料名称	性能要求
		(3) CuNiSn 系合金带箔材：抗拉强度 $\geq 1100 \text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 3\%$, 硬度 HV ≥ 350 , 导电率 $\geq 6\% \text{ IACS}$, 表面粗糙度 $R_a \leq 0.1 \mu \text{m}$ 。
5	高纯超薄键合金带	金含量 $\geq 99.99\%$, 导电率 $\geq 76\% \text{ IACS}$, 宽度: $50\text{--}1500 \mu \text{m}$, 厚度: $0.0125\text{--}0.025 \mu \text{m}$ 。
6	引线框架铜合金带材	(1) 高强高弹 Cu-Ni-Co-Si 系 (C7035)：抗拉强度 $\geq 800 \text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 5\%$, 导电率 $\geq 45\% \text{ IACS}$, 硬度 $\geq 200 \text{ HV}$, 表面粗糙度 $R_a \leq 0.1 \mu \text{m}$; (2) C19400 蚀刻引线框架材料：抗拉强度 $\geq 414 \text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 4\%$, 导电率 $\geq 60 \% \text{ IACS}$, 硬度 HV ≥ 125 , 蚀刻后翘曲高度 $\leq 0.5 \text{ mm}$; (3) C70250 蚀刻引线框架材料：抗拉强度 $\geq 610 \text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 6\%$, 导电率 $\geq 40 \% \text{ IACS}$, 硬度 HV ≥ 180 , 蚀刻后翘曲高度 $\leq 0.5 \text{ mm}$ 。
7	热致液晶聚合物(LCP)材料	高耐热 LCP 材料: 熔点 $> 360^\circ\text{C}$, $> 0.1 \text{ mm}$ 厚度样品 UL-94V0 阻燃, 介电强度 $> 40 \text{ KV/mm}$, 热变形温度 $> 310^\circ\text{C}$, $> 0.3 \text{ mm}$ 厚度样品 RTI $> 200^\circ\text{C}$, 拉伸强度 $> 160 \text{ MPa}$ 。
8	光学级聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)及其塑料光导纤维	(1) 光学级 PMMA: 折射率 1.49, 透光率 $\geq 93\%$, 熔融指数 4-10g/10min, 拉伸模量 3300MPa, 熔点 104-110°C, 邵氏硬度 100-102D; (2) 塑料光导纤维: 芯材光学级 PMMA, 包层光学级氟树脂, 损耗 $\leq 0.2 \text{ dB/m}$, 数值孔径 0.5, 弯曲半径 ≥ 10 倍光纤直径。
9	TFT-LCD 用偏光片 PVA 的保护膜	宽幅 2500mm; 厚度 $40 \pm 5 \mu \text{m}$; 全光线透过率 $\geq 91\%$; 波长 380nm 透过率: $6 \pm 3\%$; 雾度值 $\leq 1\%$; 位相差 $R_0 \leq 3$, $R_{th} \leq 3$ 。

序号	材料名称	性能要求
10	超高纯化学试剂	(1) 八甲基环四硅氧烷: 纯度 $\geq 99.9999\%$, 杂质总和 $< 5 \text{ ppb}$, Al $\leq 1 \text{ ppb}$, 钴 $\leq 1 \text{ ppb}$, 铁 $\leq 1 \text{ ppb}$, 锰 $\leq 1 \text{ ppb}$, 镍 $\leq 1 \text{ ppb}$; 水 $< 10 \text{ ppm}$; (2) 四甲基硅烷: 纯度 $\geq 99.99\%$, 杂质总和 $< 1 \text{ ppb}$, Al $\leq 0.2 \text{ ppb}$, 钴 $\leq 0.2 \text{ ppb}$, 铁 $\leq 0.2 \text{ ppb}$, 锰 $\leq 0.2 \text{ ppb}$, 镍 $\leq 0.2 \text{ ppb}$; 氯含量 $< 1 \text{ ppm}$, 水 $< 10 \text{ ppm}$, 颗粒度 ($\geq 0.2 \mu\text{m}$) $\leq 10 \text{ pcs/mL}$; (3) 正硅酸乙酯: 纯度 $\geq 99.9999\%$, 杂质总和 $< 1 \text{ ppb}$, Al $\leq 0.1 \text{ ppb}$, 钴 $\leq 0.1 \text{ ppb}$, 铁 $\leq 0.1 \text{ ppb}$, 锰 $\leq 0.1 \text{ ppb}$, 镍 $\leq 0.1 \text{ ppb}$; 氯含量 $< 0.05 \text{ ppm}$, 水 $< 5 \text{ ppm}$ 。
11	ArF 光刻胶用脂 环族环氧树脂	单项金属元素含量 $< 50 \text{ ppb}$, 环氧值 $1.95\text{--}2.15 \text{ eq}/100\text{g}$, 粘度 ≤ 30 (25°C , $\text{mPa}\cdot\text{s}$), APHA ≤ 150 。
12	集成电路用光刻 胶及其关键原材 料和配套试剂	(1) I 线光刻胶: 6 英寸、8 英寸、12 英寸集成电路制造用 I 线光刻胶; (2) KrF 光刻胶: 8 英寸、12 英寸集成电路制造光刻工艺用 KrF 光刻胶; (3) ArF/ArFi 光刻胶: 12 英寸集成电路制造光刻工艺用 ArF 和 ArFi 浸没式光刻胶; (4) 光刻胶树脂及其单体: KrF/ArF/ArFi 光刻胶专用树脂及其高纯度单体、感光性聚酰亚胺树脂; (5) 光刻胶专用光引发剂: I 线/KrF/ArF 光刻胶专用高纯度化学增幅型光致产酸剂, 纯度超过 99.50%, 且 26 种金属离子含量都低于 20 ppb ; G 线/I 线感光性化合物, 有效含量超过 97.00%, 且 26 种金属离子含量都低于 100 ppb ; (6) 光刻胶抗反射层、光刻胶顶部和光刻胶底部涂层: 与 KrF、ArF 和 ArFi 浸没式光刻胶配套的抗反射层材, 顶部涂层材以及底部涂层材; (7) 厚膜光刻胶: 3D 集成等系统级封装用光刻胶; (8) 与 KrF、ArF 和 ArFi 浸没式光刻胶配套的光刻胶显影液、剥离液、稀释剂、蚀刻液等: 稀释剂纯度 $> 99.999\%$, Al $< 50 \text{ ppb}$, Fe $< 50 \text{ ppb}$, K $< 20 \text{ ppb}$, Ti $< 10 \text{ ppb}$; 剥离液: 纯度 $> 99.999\%$, Al $< 30 \text{ ppb}$, K $< 50 \text{ ppb}$, Ti $< 10 \text{ ppb}$, Mo $< 10 \text{ ppb}$; 显影液: 纯度 $> 99.999\%$, Al $< 50 \text{ ppb}$, Fe $< 70 \text{ ppb}$, Cr $< 30 \text{ ppb}$, Ti $< 10 \text{ ppb}$; 蚀刻液: 纯度 $> 99.999\%$, Al $< 5 \text{ ppb}$, Cr $< 1 \text{ ppb}$, Fe $< 5 \text{ ppb}$, K $< 5 \text{ ppb}$ 。
13	特种气体	(1) N, N-二硅烷基-硅烷胺 (TSA): 纯度 $> 99.999\%$, Al $< 1 \text{ ppb}$, Fe $< 3 \text{ ppb}$, K $< 2 \text{ ppb}$, Mo $< 1 \text{ ppb}$, 氯化物 $< 5 \text{ ppm}$; (2) 乙硅烷: 纯度 $> 99.998\%$, H ₂ $< 200 \text{ ppmv}$, N ₂ $< 1 \text{ ppmv}$, O ₂ &Ar $< 1 \text{ ppmv}$, CO $< 1 \text{ ppmv}$, CH ₄ $< 1 \text{ ppmv}$, CO ₂ $< 1 \text{ ppmv}$, TotalChlorosilanes $< 0.2 \text{ ppmv}$, HigherSilanes $< 50 \text{ ppmv}$, SiH ₄ $< 200 \text{ ppmv}$, Siloxanes $< 5 \text{ ppmv}$,

序号	材料名称	性能要求
		H ₂ O < 1 ppmv; (3) 乙硼烷：纯度 > 99.9999%， Al < 1 ppb, Fe < 1 ppb, K < 2 ppb, Mo < 1 ppb; (4) 二氯硅烷 (DCS)：纯度 > 99.9999%， Al < 1 ppb, B < 2 ppb, Fe < 3 ppb, Ti < 1 ppb; (5) 六氯乙硅烷 (HCDS)：纯度 > 99.9999%， Al < 2 ppb, Fe < 2 ppb, K < 1 ppb, Ni < 2 ppb, 己烷 < 0.03%; (6) 正硅酸乙酯：纯度 ≥ 99.9999%，杂质总和 < 1 ppb, Al ≤ 0.1 ppb, 钴 ≤ 0.1 ppb, 铁 ≤ 0.1 ppb, 锰 ≤ 0.1 ppb, 镍 ≤ 0.1 ppb; 氯含量 < 0.05 ppm, 水 < 5 ppm; (7) 双(二乙基胺基)硅烷：纯度 ≥ 99.9999%; (8) 氩气：化学纯度 ≥ 99.999%，同位素含量 ≥ 99.7%；具体指标：N ₂ ≤ 1 ppm, O ₂ ≤ 0.5 ppm, CO ₂ ≤ 0.5 ppm, CO ≤ 0.5 ppm, 总 CH ≤ 0.5 ppm, H ₂ ≤ 50 ppm, HD ≤ 3000 ppm;
13	特种气体	(9) 高介电常数有机铪前驱体材料：产品金属纯度 > 99.9999%， Zr < 20 ppb, Ti < 20 ppb, Li < 10 ppb, C1 < 10 ppm; (10) 高介电常数有机锆前驱体材料：产品金属纯度 > 99.9999%， Hf < 50 ppb, Ti < 30 ppb, Li < 10 ppb, C1 < 10 ppm; (11) ppb 级超高纯氮气 (GN ₂)：O ₂ < 50 ppbv, H ₂ < 50 ppbv, H ₂ O < 95 ppbv, CO < 10 ppbv, CO ₂ < 10 ppbv, THC < 50 ppbv, Particle < 5 ppbv; (12) ppb 级超高纯氮气 (PN ₂)：O ₂ < 1 ppbv, H ₂ < 1 ppbv, H ₂ O < 1 ppbv, CO < 1 ppbv, CO ₂ < 1 ppbv, THC < 1 ppbv, Particle < 1 ppbv; (13) ppb 级超高纯氧气 (PO ₂)：N ₂ < 100 ppbv, Ar < 100 ppbv, H ₂ < 1 ppbv, H ₂ O < 1 ppbv, CO < 1 ppbv, CO ₂ < 1 ppbv, THC < 1 ppbv, Particle < 1 ppbv; (14) ppb 级超高纯氩气 (PAr)：N ₂ < 1 ppbv, O ₂ < 1 ppbv, H ₂ < 1 ppbv, H ₂ O < 1 ppbv, CO < 1 ppbv, CO ₂ < 1 ppbv, THC < 1 ppbv, Particle < 1 ppbv; (15) ppb 级超高纯二氧化碳 (PCO ₂)：O ₂ < 1 ppbv, H ₂ < 1 ppbv, H ₂ O < 1 ppbv, CO < 1 ppbv, Particle < 1 ppbv; (16) ppb 级超高纯氦气 (PHe)：N ₂ < 1 ppbv, O ₂ < 1 ppbv, H ₂ < 1 ppbv, H ₂ O < 1 ppbv, CO < 1 ppbv, CO ₂ < 1 ppbv, THC < 1 ppbv, Particle < 1 ppbv; (17) ppb 级超高纯氢气 (PH ₂)：N ₂ < 1 ppbv, O ₂ < 1 ppbv, H ₂ < 1 ppbv, CO < 1 ppbv, CO ₂ < 1 ppbv, THC < 1 ppbv, Particle < 1 ppbv。

序号	材料名称	性能要求
14	超薄电子布	(1) 106 电子布：经纬密度 22×22 根/cm，厚度 0.033 ± 0.01 mm，单位面积质量 24 ± 1 g/m ² ； (2) 1037 电子布：经纬密度 27.6×28.7 根/cm，厚度 0.027 ± 0.01 mm，单位面积质量 23 ± 1 g/m ² ； (3) 超薄型电子布 1067：经纬密度 27.6×27.6 根/cm，厚度 0.035 ± 0.01 mm，单位面积质量 30.7 ± 1 g/m ² ； (4) 极薄型电子布 1027：经纬密度 29.5×29.5 根/cm，厚度 0.019 ± 0.01 mm，单位面积质量 20 ± 1 g/m ² ； (5) 极薄型电子布 1017：经纬密度 37.4×37.4 根/cm，厚度 0.014 ± 0.01 mm，单位面积质量 12 ± 1 g/m ² 。
15	g/i 线正性光刻胶用酚醛树脂	单项金属元素含量 < 50ppb，游离单体 < 1%，分子量范围 2000-30000，dimer 含量 3-10%。
16	银反射膜	附着力等级 0 级 (GB/T9286-1998)，硬度 ≥ HB，反射率 ≥ 95%。
17	平板显示用光刻胶及其关键原材料和配套试剂	(1) 彩色滤光膜负性光刻胶：①黑色矩阵：粘度： 2.2 ± 0.2 mPa·s，固含量： 14.9 ± 0.3 wt%，OD ≥ 4.0 / μm，表面阻抗 ≥ 1.0E+06；树脂 Mw：≤ 20000，PDI ≤ 3.0，酸值 ≤ 180mgKOH/g，固含量：40.0%-60.0%，金属离子 ≤ 100ppm；②间隙子：透明液体、无异物、粘度： 3.0 ± 0.5 mPa·s、固含量： $18 \pm 1.2\%$ 、膜厚（曝光后 1.21 ± 0.15 μm、后烘后 1.05 ± 0.15 μm）、TopCD= 5.3 ± 1.5 μm、BottomCD= 12.5 ± 1.5 μm、分辨率 ≤ 14 μm；树脂 Mw：3000-30000，PDI ≤ 3.5，酸值 ≤ 200mgKOH/g，固含量：20.0%-60.0%，金属离子 ≤ 100ppm；③平坦层：透明液体、无异物、粘度： 2.2 ± 1 mPa·s、固含量 (13.7 ± 1.3) %；树脂 Mw：3000-30000，PDI ≤ 3.0，酸值 ≤ 200mgKOH/g，固含量：20.0-40.0%，金属离子 ≤ 100ppm；④彩色光刻胶：粘度： 3 ± 0.5 mPa·s、固含量：15wt%、残膜率 > 80%、综合色域 > 45%NTSC，RY > 20，GY > 50，树脂 Mw：2000-30000，PDI < 3.5，酸值 ≤ 200mgKOH/g，固含量：20.0-60.0%，金属离子 ≤ 100ppm，BY > 10； (2) LCD 用负型光刻胶用树脂：①黑色光刻胶用树脂：Mw：≤ 20000，PDI ≤ 3.0，酸值 ≤ 180mgKOH/g，固含量：40.0-60.0%；②间隙子光刻胶用树脂：Mw：3000-30000，PDI ≤ 3.0，酸值 ≤ 200mgKOH/g，固含量：20.0-40.0%；③平坦层光刻胶用树脂：Mw：3000-30000，PDI ≤ 3.5，酸值 ≤ 200mgKOH/g，固含量：20.0-60.0%；④彩色光刻胶用树脂：Mw：2000-30000，PDI < 3.5，酸值 ≤ 200mgKOH/g，固含量：20.0-60.0%；进行重均分子量 (Mw)、分子量分布 (PDI)、酸值、金属离子 (< 100ppm) 等核心指标的管控； (3) AMOLED 用正性光刻胶：解像度 ≤ 2 μm，Hole ≤ 3 μm，金属离子含量 (Na、Fe、Zn 等) ≤ 200ppb； (4) 铜蚀刻液：pH：1.5-4.5，氟离子含量 300-3000ppm，无机酸或有机酸含量 0-20%，双氧水含量 ≤ 25%，颗粒杂质数 (> 0.5 μm) < 100 个/mL，金属离子 (Li、Mg、Al、Cr、Mn、Fe、Ni、Co、Cu、Zn、Sr、Cd、

序号	材料名称	性能要求
		Ba、Pd) < 1ppm; 金属离子 Na、Ca < 3ppm; (5) 高性能彩色色浆材料: 粘度: $3 \pm 0.5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$, 固含量: 15wt%, 残膜率 > 80%, 综合色域 > 45%NTSC, RY > 20, GY > 50, BY > 10。①红色色浆: 对比度: ≥ 6000 , Y 值: ≥ 16.5 ; ②绿色色浆: 对比度: ≥ 11000 , Y 值: ≥ 54 ; ③蓝色色浆: 对比度: ≥ 7000 , Y 值: ≥ 10.5 。以上三色色度变化: 在 250°C 加热 1 小时之后 ≤ 3 ; 色浆粒径: D50 $\leq 80 \text{ nm}$; 粘度变化(3 个月): $\leq 20\%$; ④黑色色浆: 高阻抗值: $> 109 \Omega$, 光密度值: > 3.5 。
18	柔性显示盖板用透明聚酰亚胺	透光率 > 89%, 可弯折次数 ≥ 20 万次。
19	I-线光敏型聚酰亚胺(PI)绝缘材料	(1) OLED 用正型绝缘材料: 固化温度 $\leq 230^\circ\text{C}$, 显影留膜率 $\geq 70\%$, 锥度角 20–40°, PCT 试验 $\geq 500\text{hr}$ (SiO ₂ Glass); (2) 晶圆级封装用负型绝缘材料: 固化温度 $\leq 200^\circ\text{C}$, 与铜附着力 $\geq 60\text{MPa}$ 。
20	液晶显示用聚酰亚胺(PI)取向剂	(1) 摩擦取向型聚酰亚胺液晶取向剂: VHR $\geq 97\%$; 预倾角(Pre-tilt angle): 1.5–2.8°; RDC (mV) 100; (2) 光取向型聚酰亚胺液晶取向剂: 波长: 254nm; 预倾角(Pre-tilt angle): 0–1°; RDC (mV) < 300 ; (3) PSVA 型 TFT 液晶显示用聚酰亚胺取向剂: 波长 313nm, 预倾角 88–89 度, VHR $> 97\%$ (5V), IonDensity $< 300\text{pC}$ 。
21	光学级聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基膜	光学性能: R ₀ $< 1.5 \text{ nm}$, R _{th} 2.0–3.5 nm, 透过率 $\geq 90\%$, 雾度 $< 1\%$, b 值 < 1 , 表面硬度 $\geq 2\text{H}$ 。
22	光学级三醋酸纤维薄膜(TAC)基膜	光学性能: R ₀ $< 1.0 \text{ nm}$, R _{th} 20–10 nm, 透过率 $\geq 90\%$, 拉伸强度 $\geq 60\text{MPa}$, 断裂拉伸率 $\geq 10\%$, 尺寸收缩率 $\leq 0.5\%$ 。
23	光学级聚乙烯(PVA)膜	光学性能: 偏光度 $\geq 90\%$, 透过率 $\geq 40\%$, 完全溶解温度 $\geq 70^\circ\text{C}$, 水分率 $< 2.5\%$, 面积膨润度 MD > 1.15 、TD > 1.15 。
24	半导体用高纯石英玻璃制品	(1) 石英扩散管: 外径 300–400 mm, 偏壁厚 $\leq 0.6 \text{ mm}$, 金属杂质含量 $< 13 \text{ ppm}$; (2) 石英外管、内管、工艺管、石英舟: 羟基含量 $< 30 \text{ ppm}$, 垂直度 $< 1 \text{ mm}$, 管口平面度 $< 0.1 \text{ mm}$, 壁厚偏差 $< 0.5 \text{ mm}$ 。
25	高品质紫外光学	直径或对角线 $\geq 600 \text{ mm}$, 光吸收系数 $\leq 2 \times 10^{-5}$ @ 1053 nm, 光学非均匀性 $\leq 4 \times 10^{-6}$, 应力 $\leq 5 \text{ nm/cm}$, 条纹度 5

序号	材料名称	性能要求
	石英玻璃	级。
26	半导体装备用精密碳化硅陶瓷部件	弹性模量 $\geq 350\text{GPa}$, 抗弯强度 $\geq 350\text{MPa}$, 韦伯模数 ≥ 8.0 , 导热系数 $\geq 180\text{W/(m \cdot K)}$, 热膨胀系数 $\leq 4.5 \times 10^{-6}\text{^{\circ}C}^{-1}$, 密度 $\geq 3.0\text{g/cm}^3$ 。
27	高纯度元素级硫化锌晶体	纯度 99.99%, 粒径 0.1-0.3 μm, 法向透过率 $\geq 85\%$ (3-5 μm、8-10.5 μm, 4mm 厚度), 抗热冲击性能: 窗口外表面温升速率 60°C/s, 最高升至 500°C 的条件下, 不破裂, 膜层不脱落。
28	高精度 SC 切型压电石英晶片	Phi (XX') 角度范围: 18° 30' - 26° 00', Theta (ZZ') 角度范围: 33° 15' - 34° 30', 角度公差: $\pm 15''$, 尺寸公差: $\pm 0.003\text{mm}$, 基频范围: 19-54MHz, 频率公差: $\pm 20\text{KHz}$ 。
29	10B 富集的 ZrB ₂ 靶材	纯度 $> 99.5\%$, 密度 $> 92\%$, 10B 丰度 54.3-55.3%。
30	高性能各向异性粘结磁体	(1) 粘结磁粉: Br $\geq 12.5\text{kGs}$, (BH) max (MG0e) + Hcj (k0e) ≥ 52 ; (2) 粘结磁体: Br $\geq 8.8\text{kGs}$, (BH) max (MG0e) + Hcj (k0e) > 30 。
31	超高纯稀土金属材料及制品	(1) 超高纯稀土金属材料: 以 60 种以上主要杂质计算, 绝对纯度 $> 99.99\%$, 气体杂质总量 $< 100\text{ppm}$; (2) 超高纯稀土金属靶材: 最大方向尺寸 $\geq 300\text{mm}$; 绝对纯度 $> 99.95\%$, 晶粒平均尺寸 $< 200\text{ }\mu\text{m}$ 。
32	稀土抛光材料	高档稀土抛光液, 粉体 CeO ₂ 含量 $\geq 99.9\%$, 晶粒尺寸 $\leq 30\text{nm}$, 形貌接近球形, 抛光液粒度 D50=50-300nm, D _{max} $< 500\text{nm}$, 有害杂质离子浓度 $< 40\text{ppm}$, 硅晶片抛光速度 $\geq 100\text{nm/min}$, 表面粗糙度 R _a $\leq 1\text{nm}$, 高性能玻璃基片抛光速度 $\geq 25\text{nm/min}$, 表面粗糙度 R _a $\leq 0.5\text{nm}$ 。
33	铝钪合金靶材	(1) Sc 原子含量 5-25at%, 纯度 $\geq 99.95\%$, O 杂质含量 $\leq 300\text{ppm}$, Sc 原子质量波动 $\leq \pm 0.5\text{at\%}$, 合金相平均尺寸 $\leq 50\text{ }\mu\text{m}$, 靶材与背板焊合率 $\geq 97\%$; (2) Sc 原子含量 25-43at%, 纯度 $\geq 99.9\%$, O 杂质含量 $\leq 800\text{ppm}$, Sc 原子质量波动 $\leq \pm 0.5\text{at\%}$, 合金相平均尺寸 $\leq 50\text{ }\mu\text{m}$, 靶材与背板焊合率 $\geq 95\%$, 最大尺寸 $\geq 300\text{mm}$ 。
34	超高纯 NiPt 合金靶材	纯度 $\geq 4\text{N}$, 晶粒尺寸 $\leq 100\text{ }\mu\text{m}$, 焊合率 $\geq 97\%$, 尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$, 表面粗糙度 R _a $\leq 0.4\text{ }\mu\text{m}$, 满足集成电路领域 300mm 晶圆或功率器件制造要求。
35	高纯钴靶	纯度 $\geq 99.995\%$ (4N5), 晶粒尺寸 $\leq 50\text{ }\mu\text{m}$, 焊合率 $> 99\%$, 满足 200-300mm 晶圆制造要求。

序号	材料名称	性能要求
36	高纯钽靶材	纯度 $\geq 99.995\%$ (4N5)，晶粒尺寸 $\leq 50 \mu m$ 且均匀，圆形、方形各种规格，在厚度上应为均匀晶粒取向的组织结构，表面粗糙度 $R_a \leq 1.6 \mu m$ 。
37	Ag 及 Ag 合金靶材	(1) 平面显示用银及银合金靶材：纯 Ag 纯度 $\geq 99.99\%$ ，Ag 合金纯度 $\geq 99\%$ ；平均晶粒 $\leq 150 \mu m$ ，焊合率 $\geq 95\%$ ；靶材尺寸：旋转靶单节圆筒 ($\Phi 100-165$) \times (400-3500) \times (4-20) mm；靶材成膜后，在 500nm 光照下，反射率 $\geq 92\%$ ；平面靶单片靶胚 G2.5-G11TFT-LCD 世代线 (600-2500) \times (180-1800) \times (4-20) mm； (2) 200-300mm 晶圆用纯 Ag 靶材：纯度 $\geq 99.99\%$ ，平均晶粒 $\leq 100 \mu m$ ，焊合率 $\geq 97\%$ ，最大外径 $\geq 300mm$ 。
38	铜和铜合金靶	(1) 高纯铜靶：纯度 $\geq 6N$ ，金属杂质元素含量均 $\leq 0.2ppm$ ，非金属杂质元素含量均 $\leq 1ppm$ ，最大外径 $\geq 400mm$ ，尺寸公差 $\pm 0.1mm$ ，焊合率 $\geq 99\%$ ，表面粗糙度 $R_a \leq 0.4 \mu m$ ，满足集成电路领域 300mm 晶圆制造要求； (2) 高纯铜合金靶：纯度 $\geq 6N$ ，合金元素含量 0.11-0.80wt%，合金元素公差范围 $\leq \pm 10\%$ ，分布均匀，金属杂质元素含量均 $\leq 0.2ppm$ ，非金属杂质元素含量均 $\leq 1ppm$ ，最大外径 $\geq 400mm$ ，尺寸公差 $\pm 0.1mm$ ，焊合率 $\geq 99\%$ ，表面粗糙度 $R_a \leq 0.4 \mu m$ ，满足集成电路领域 300mm 晶圆制造要求。
39	氮化镓单晶衬底	4 英寸及以上，位错密度 $< 5 \times 10^6 cm^{-2}$ ，表面粗糙度 $< 0.3nm$ ，N 型氮化镓单晶衬底电阻率 $< 0.05 \Omega \cdot cm$ ，半绝缘氮化镓单晶衬底电阻率 $> 10^6 \Omega \cdot cm$ 。
40	氮化镓外延片	4 英寸及以上，方阻 $< 400 \Omega / \square$ ，二维电子气浓度 $> 8 \times 10^{12} cm^{-2}$ ，翘曲 $< 50 \mu m$ ，迁移率 $> 1500 cm^2/vs$ 。
41	Ga ₂ O ₃ 单晶衬底	晶体直径： ≥ 3 英寸；平均位错密度： $\leq 10^5/cm^2$ ；电子浓度： $10^{18}-10^{19}/cm^3$ ；双晶摇摆曲线半高宽： $\leq 50''$ ；基片表面粗糙度：RMS $\leq 0.5nm$
42	Ga ₂ O ₃ 外延片	(1) 半绝缘：厚度：200-300nm；外延直径： ≥ 3 英寸；电子浓度： $\leq 10^{17}/cm^3$ ；双晶摇摆曲线半高宽： $\leq 80''$ ；基片表面粗糙度：RMS $\leq 0.6nm$ ； (2) 导电：厚度： $7 \mu m$ ；外延直径： ≥ 3 英寸；电子浓度： $\geq 10^{18}/cm^3$ ；双晶摇摆曲线半高宽： $\leq 150''$ 。
43	碳化硅同质外延片	4 英寸及以上，外延片内浓度不均匀性 ($\sigma / mean$) $< 15\%$ ，外延片内厚度不均匀性 ($\sigma / mean$) $< 10\%$ ，外延表面缺陷密度 $< 3g/cm^2$ ，外延表面粗糙度 $< 0.5nm$ 。

序号	材料名称	性能要求
44	碳化硅单晶衬底	6 英寸及以上，微管密度 $< 0.5/\text{cm}^2$, TTV $< 10 \mu\text{m}$, $-25 \mu\text{m} < \text{bow} < 25 \mu\text{m}$, warp $< 45 \mu\text{m}$, 表面粗糙度 Ra $< 0.15\text{nm}$; N 型碳化硅衬底电阻率 $0.015\text{--}0.025 \Omega \cdot \text{cm}$, 半绝缘碳化硅衬底电阻率 $\geq 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 。
45	大尺寸硅电极产品	纯度 $\geq 11\text{N}$ (不计调整电阻率而掺入的杂质), 外径 $> 300\text{mm}$, 公差 $\pm 10 \mu\text{m}$, 硅电极电阻率: (1) 低阻 ($0.005\text{--}0.015 \text{ohm} \cdot \text{cm}$) ; (2) 高阻 ($1\text{--}5 \text{ohm} \cdot \text{cm}$) ; (3) 超高阻 ($60\text{--}80 \text{ohm} \cdot \text{cm}$), 径向电阻率波动 $< 10\%$, 表面粗糙度 $\leq 10\text{nm}$, 硅电极导气微孔均匀性 $\geq 98\%$, 硅电极导气微孔边缘倒角 $R0.2 \pm 0.1\text{mm}$ 。
46	4-6 英寸低位错 锗单晶	单晶直径 $\geq 104\text{mm}$, 单晶长度 $\geq 120\text{mm}$, 单晶晶向: $<100>$ 偏 $<111> 9^\circ \pm 1^\circ$, 导电型号 P 型, 电阻率 $0.001\text{--}0.05 \Omega \cdot \text{cm}$, 径向电阻率不均匀性 $\leq 15\%$, 位错密度 $\leq 500/\text{cm}^2$ 。
47	电子封装用热沉 复合材料	(1) WCu: 熔渗态密度 $\geq 11.6\text{g/cm}^3$, CTE $6.5\text{--}13.5 \text{ppm/K}$, TC $165\text{--}290 \text{W/m} \cdot \text{K}$; (2) MoCu: 轧制退火态密度 $\geq 9.2\text{g/cm}^3$, 熔渗态密度 $\geq 9.1\text{g/cm}^3$, CTE $6.5\text{--}13.5 \text{ppm/K}$, TC $155\text{--}210 \text{W/m} \cdot \text{K}$; (3) CMC: CTE $7\text{--}10 \text{ppm/K}$, TC $150\text{--}300 \text{W/m} \cdot \text{K}$; (4) CPC: CTE $8\text{--}11.5 \text{ppm/K}$, TC $180\text{--}300 \text{W/m} \cdot \text{K}$ 。
48	硅基微阵列透镜	硅基底, 口径 $230 \mu\text{m}$ 与 $700 \mu\text{m}$, 周期 $250 \mu\text{m}$ 与 $750 \mu\text{m}$, 曲率半径 0.3mm 、 1.4mm 、 1.9mm 、 3.1mm 、 4.0mm ; 厚度 $300\text{--}500 \mu\text{m}$ 。
49	5G 滤波器专用 浆料	粘度 (Kcps/25°C) : 10 ± 3 ; 含银量 (%) 73.5 ± 2.0 ; 无机物含量 (%) 78.0 ± 2.0 。
50	4K/8K 用混合 液晶	$\gamma_{1/\text{K11}}$: 4.42mPa.s/pN 标准 $< 4.6 \text{mPa.s/pN}$; 透过率: 5.20% , 标准: $> 5.10\%$ 。
51	高性能超精密贵 金属预成型焊片	清洁性: I 级; 溅散性: A 级; 符合标准 GB/T18762-2017; 表面粗糙度: $0.8\text{--}1.6 \mu\text{m}$; 杂质元素: Pb $\leq 0.005\%$; Zn $\leq 0.005\%$; Cd $\leq 0.005\%$ 。

序号	材料名称	性能要求
52	金锡合金钎料	合金组分: Au: $80 \pm 0.5\text{wt\%}$, Sn 余量; 杂质元素总含量小于 0.1wt\% , 氧、碳含量均小于 200ppm; (1) 合金箔带材及制品: 厚度 $0.01\text{mm}-0.05\text{mm}$ (含), 允许偏差 $\pm 0.003\text{mm}$; 厚度 $0.05\text{mm}-0.10\text{mm}$, 允许偏差 $\pm 0.005\text{mm}$; 宽度 $\geq 50\text{mm}$, 允许偏差 $\pm 2\text{mm}$; 宽度 $< 50\text{mm}$, 允许偏差 $\pm 1\text{mm}$; 表面粗糙度 (R_z) $\leq 1.6 \mu\text{m}$; (2) 合金焊粉及焊膏: 3号粉粒度分布 ($25-43 \mu\text{m}$) 大于 90%; 5号粉粒度分布 ($15-25 \mu\text{m}$) 大于 90%; 合金焊膏体保质期为 6 个月, 期间无粉剂分离现象。
53	OLED 空穴注入材料	(1) 空穴注入 1: HPLC $> 99.9\%$, TGA(热失重 5%) $> 520^\circ\text{C}$, $T_g > 140^\circ\text{C}$, 最大杂质 $\leq 0.05\%$ 。在电流密度 20mA/cm^2 下, 器件电压 $< 4\text{V}$, 亮度 $> 10000\text{cd/m}^2$, CE $> 60\text{cd/A}$, PE $> 451\text{m/W}$, EQE $> 17\%$, CIE ($0.35, 0.60$), 寿命 LT95 > 500 小时; (2) 空穴注入 2: HPLC $> 99.9\%$, TGA(热失重 5%) $> 540^\circ\text{C}$, $T_g > 130^\circ\text{C}$, $T_m > 240^\circ\text{C}$, 最大杂质 $\leq 0.05\%$ 。在电流密度 20mA/cm^2 下, 器件电压 $< 4\text{V}$, 亮度 $> 10000\text{cd/m}^2$, CE $> 60\text{cd/A}$, PE $> 451\text{m/W}$, EQE $> 17\%$, CIE ($0.35, 0.60$), 寿命 LT95 > 500 小时。
54	OLED 用发光层材料	(1) 绿光主体及掺杂材料: 色度坐标达到 $\text{CIEy} \geq 0.72$, 10000cd/m^2 亮度下, 效率 $> 160\text{cd/A}$, 寿命 $\text{LT}_{95} > 1000$ 小时; (2) 红光主体及掺杂材料: 色度坐标达到 $\text{CIEx} \geq 0.68$, 5000cd/m^2 亮度下, 效率 $> 60\text{cd/A}$, 寿命 $\text{LT}_{95} > 4000$ 小时;
55	OLED 用传输层材料	(1) 有机小分子电子传输层材料(ET): 玻璃化转变温度 $> 130^\circ$, 能带宽度 (E_g) $> 2.7\text{eV}$, 迁移率 (Mobility) $> 5.0 \times 10^{-5}\text{cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$; (2) 有机小分子空穴传输层材料(HT): 玻璃化转变温度 $> 130^\circ$, 能带宽度 (E_g) $> 2.5\text{eV}$, 迁移率 (Mobility) $> 1.0 \times 10^{-3}\text{m}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$; 自主 HT+ET, 蓝光器件达到 2000nits 下, 驱动电压 $< 3.6\text{V}$, 效率 (BlueIndex) > 160 , 寿命 $\text{T}_{95} > 150$ 小时。
56	MiniledMicro 封装胶	(1) 背光用有机硅封装胶; 触变指数 ≥ 3.0 ; 透光率 $\geq 90\%$ (450nm); 硬度 $\geq D35$; 操作时间 $\geq 4\text{hr}$; 固化时间 $\leq 60\text{min}$; (2) 直显用有机硅/环氧树脂封装胶; 固化收缩率 $\leq 3\%$; 线膨胀系数 CTE2 $\leq 240\text{ppm}/\text{^\circ C}$; 剪切强度 (A1-A1) $\geq 3\text{MPa}$; 透氧率 $\leq 300\ (\text{cm}^3/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h} \cdot 0.1\text{MPa}))$ 。

序号	材料名称	性能要求
57	钙钛矿量子点光学膜	薄膜均匀性大于 90%，厚度小于 300 微米，60 摄氏度/90% 相对湿度加速老化 1000 小时光衰小于 10%。薄膜产品应用在 LCD 背光的亮度达到 500 尼特，色域达到 110%NTSC。
58	高性能掺杂钨材料	(1) 碱金属掺杂钨基材料: W ≥ 99.95%, K 含量 15–40ppm, 平均晶粒尺寸 ≤ 10 μm 且均匀, 硬度 ≥ 360Hv, 密度 ≥ 18.9 g/cm³; (2) 稀土掺杂钨基材料: W ≥ 97.0%, 稀土总含量 1.0–3.0%, Na 含量 ≤ 10ppm, K 含量 ≤ 10ppm, 强度 ≥ 1700MPa, 硬度 ≥ 350Hv, 平均晶粒尺寸 ≤ 30 μm 边部和心部密度均匀, 密度 ≥ 18.5 g/cm³。
59	先进电子器件用高疲劳镍钛形状记忆合金材料	氧含量 ≤ 300ppm, 碳含量 ≤ 100ppm; 完全退火状态奥氏体转变结束温度 Af ≤ -30℃ 或 Af ≥ 100℃; 抗拉强度 ≥ 1400Mpa, 延伸率 ≥ 10%。
60	高性能钇铝石榴石(YAG)系列激光晶体	PV ≤ 0.08/inch, 消光比 ≥ 30dB, 表面粗糙度 ≤ 0.7nm, 单程损耗系数 ≤ 0.1%/cm。
61	晶体生长用热解氮化硼容器	密度: 1.95—2.20g/cm³; 纯度: ≥ 99.9995%; 高度: 100–500mm (坩埚); 长度: 100–500mm (舟); 厚度: 0.4–2.0mm (坩埚); 0.8–1.2mm (舟); 拉伸强度: ≥ 112MPa; 外径: 2 英寸–20 英寸;
二 生物材料		
62	聚硼硅氧烷改性聚氨酯材料	密度 0.45–0.5kg/m³, 撕裂强度 0.9–1.5N/mm, 拉伸强度 > 1.4MPa, 断裂伸长率, 180–300%, 压缩强度 140–300kPa, 抗冲击防护性能 level12。
63	生物基增塑剂	100% 替代邻苯类增塑剂, 抗老化性能 > 1200h (ASTMG-154), 环保指标通过欧盟 REACH 法规认证, 绿色安全无毒。
64	高生物相容性血液透析膜	超滤系数达到 60mL/h · mmHg 以上; 肌酐, 尿素清除率均在 180mL/min 以上, 白蛋白的筛选 < 0.005, β2 微球蛋白的筛选 > 0.85。可承受 500mmHg 的跨膜压力; 抗蛋白污染能力和生物相容性优。

序号	材料名称	性能要求
65	微创介入医疗中空纤维管	细胞增值率 $\geq 70\%$; 尺寸公差 $\pm 0.01\text{mm}$; 耐爆破压强度 $\geq 20\text{atm}$; 以下根据材料的不同用途分别说明: (1) 用于微创介入医疗中空纤维管囊主要性能指标: 尺寸公差 $\pm 0.01\text{mm}$, 断裂伸长率可控制, 球囊双壁厚=1.15–1.25mm, 耐爆破压高达30–32atm; (2) 用于微创介入医疗左右冠共用造影导管主要性能指标: 正向扭控 260° , 反向扭控 140° ; (3) 用于微创介入医疗编织增强复合中空纤维管主要性能指标: 弯曲载荷5.63N, 扭控性能377.5; (4) 用于微创介入医疗三维编织增强复合中空纤维管主要性能指标: 支架载入阻力50–70N; (5) 用于微创介入医疗Coil增强复合中空纤维管主要性能指标: 外管释放阻力 $\leq 80\text{N}$, 覆膜套管释放阻力 $\leq 40\text{N}$, 轴向拉伸强度170–200N。
66	医用铂合金丝材	满足YY0450.1耐腐蚀试验要求; 丝材直径为0.02mm–0.1mm。 (1) 铂钨丝: 钨含量: 5%–20%wt。 (2) 铂镍丝: 镍含量: 5%–20%wt。 (3) 铂铱丝: 铱含量: 5%–25%wt。
67	医用PMP/PP中空纤维膜	(1) PP中空纤维膜: 拉伸强度 $\geq 50\text{cN}$, 氮气通量 $\geq 0.27\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{kPa})$; (2) PMP中空纤维膜: 拉伸强度大于50cN, 氮气通量大于 $0.0012\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{kPa})$ 。
68	高仿生可降解再生人工骨修复材料	化学组成: 材料主要是由I型胶原、羟基磷灰石组成, 羟基磷灰石含量 $45\% \pm 5\%$; 钙、磷原子比为 $1.65 \leq \text{Ca}/\text{P} \leq 1.82$; 容重: $0.2\text{--}0.3\text{g/cm}^3$; 浸提液的pH值为 7.0 ± 1.0 ; 孔隙率为70%–88%; 孔隙大小为 $300 \pm 250 \mu\text{m}$; 在模拟体液中浸泡24小时, 产品的尺寸变化小于10%; 无热原。
69	第四代聚羟基脂肪酸酯(PHA)材料-P34HB	树脂: 密度 $1.13\text{--}1.35\text{g/cm}^3$, 熔体流动速率 $6.0\text{--}8.0\text{g}/10\text{min}$, 熔点 $140\text{--}170^\circ\text{C}$, 拉伸强度 $20\text{--}26\text{MPa}$, 拉伸断裂伸长率5–400%, 悬臂梁缺口冲击强度 $3\text{--}43\text{KJ/m}^2$, 含水率 $\leq 0.5\%$ 。
70	磷硅酸盐基多孔材料	感官指标: 外观白色粉末, 无结粒, 目测无杂质; 理化指标: pH值(5%水分散体) $7.0\text{--}10.0$, 白度(WG)% ≥ 91 , 干燥失重/% ≤ 5.0 , 含量(以干剂计)/% ≥ 99 , 粒度(μm) $D_{50} \leq 20$, 比表面积/ $(\text{m}^2/\text{g}) \geq 160$, 矿化层形成时间/d ≤ 5 ; 卫生指标: 微生物指标菌落总数/(CFU/g) ≤ 100 , 霉菌和酵母菌总数/(CFU/g) ≤ 100 , 耐热大肠菌群/g不应检出, 金黄色葡萄球菌/g不应检出, 铜绿假单胞菌/g不应检出, 有害物质砷(As)/(mg/Kg) ≤ 2 , 镉(Cd)/(mg/Kg) ≤ 5 , 汞(Hg)/(mg/Kg) ≤ 1 , 铅(Pb)/(mg/Kg) ≤ 10 。

序号	材料名称	性能要求
71	医用超滤膜包	过滤面积 0.1m^2 , 截留分子量 100kD 和 300kD, 0.068MPa 压力下, 润湿膜包完整性测试空气流量 < $12\text{mL/min}(0.1\text{m}^2)$, 0.1MPa 下 300kD 膜包渗透通量 > $60\text{L/h}(0.1\text{m}^2)$, 膜包提取物中己内酰胺、全氟辛烷磺酰基化合物 PFOS、全氟辛酸 PFOA、抗氧剂 BHT、N-亚硝基二苯胺、邻苯二甲酸二丁酯无检出。
72	细胞培养片状载体	生物负载 < 0.5CFU/g , 内毒素 < 0.05EU/ml , 细胞毒性 “0” 级。
73	X 射线管用旋转阳极靶	TZM 层密度: $\geq 9.8\text{g/cm}^3$, 氧含量 $\leq 100\text{ppm}$, 三点抗弯强度 $\geq 900\text{MPa}$; WRe 层密度: $\geq 18\text{g/cm}^3$, 氧含量 $\leq 30\text{ppm}$ 。
74	医用高性能镍钛形状记忆合金	氧含量 $\leq 300\text{ppm}$, 碳含量 $\leq 100\text{ppm}$, 夹杂物最大尺寸 $\leq 20.0\mu\text{m}$, 夹杂物面积占比 $\leq 2.8\%$; 完全退火状态奥氏体转变结束温度 Af 一致性 $\pm 5^\circ\text{C}$; 抗拉强度 $\geq 1300\text{Mpa}$, 延伸率 $\geq 12\%$; 细胞毒性 ≤ 1 级, 无急性全身毒性反应, 溶血率 $\leq 5\%$ 。
75	疫苗灭活剂	产品纯度大于 98.5%, 符合《生物制品生产用原材料及辅料质量控制》的规定。
76	聚乳酸 3D 打印线材	密度 $1.24 \pm 0.02\text{g/cm}^3$, 熔点 $\geq 165^\circ\text{C}$, 含水率 $\leq 0.5\%$, 线材拉伸负荷 $1.75\text{mm} \geq 125\text{N}$ 、 $2.85\text{mm} \geq 340\text{N}$, 线材断裂伸长率 $1.75\text{mm} \geq 10\%$ 、 $2.85\text{mm} \geq 6\%$, 线材弯折性能 ≥ 10 次。
三 航空航天材料		

序号	材料名称	性能要求
77	航空发动机用变形高温合金锻件	(1) GH4065A: 盘件直径 > 600mm, 晶粒度 8 级或者更细, 允许个别 4 级; 室温拉伸: $R_m \geq 1520 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 1100 \text{ MPa}$, $A \geq 14\%$; $Z \geq 14\%$; 650°C 拉伸: $R_m \geq 1365 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 1025 \text{ MPa}$, $A \geq 11\%$; $Z \geq 11\%$; 700°C / 690MPa, 68h 残余变形 $\leq 0.2\%$; 650°C / 950MPa 持久寿命 $\tau \geq 50\text{h}$; (2) GH4169D: 室温拉伸性能: $R_m \geq 1390 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 1050 \text{ MPa}$, $A \geq 15\%$, $Z \geq 15\%$; 704°C 拉伸: $R_m \geq 1014 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 807 \text{ MPa}$, $A \geq 13\%$, $Z \geq 15\%$; 704°C / 621MPa 持久寿命 $\tau \geq 39\text{h}$, $A \geq 8\%$, 无缺口敏感性; (3) GH4720Li: 平均晶粒度 8 级或更细; 室温拉伸性能: $R_m \geq 1530 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 1100 \text{ MPa}$, $A \geq 9.0\%$, $Z \geq 10.0\%$; 650°C 拉伸性能: $R_m \geq 1350 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 1025 \text{ MPa}$, $A \geq 10.0\%$, $Z \geq 10.0\%$; 730°C / 530MPa 持久寿命 $\tau \geq 30\text{h}$, $A \geq 5\%$; 630°C / 830MPa 持久性能: $\tau \geq 30\text{h}$, $A \geq 5\%$; (4) GH4096: 室温拉伸性能: $R_m \geq 1480 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 1050 \text{ MPa}$, $A \geq 14\%$, $Z \geq 16\%$; 750°C 拉伸性能, $R_m \geq 1120 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 890 \text{ MPa}$, $A \geq 10\%$, $Z \geq 12\%$; 704°C / 690MPa 蠕变性能, 68h 残余变形 $\epsilon_p \leq 0.2\%$; 水浸探伤不存在尺寸当量 $> \Phi 0.4\text{-}15 \text{ dB}$ 的缺陷。
78	航空航天用变形高温合金材料	(1) GH3230: 棒材和锻件: 室温拉伸性能: $R_m \geq 758 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 310 \text{ MPa}$, $A \geq 35\%$, 硬度 HBW ≤ 241 ; 950°C 拉伸性能: $R_m \geq 175 \text{ MPa}$, $A \geq 35\%$; 927°C / 62MPa 持久寿命 $\tau \geq 24\text{h}$, $A \geq 10\%$; 板材: 室温拉伸性能: $R_m \geq 793 \text{ MPa}$, $R_{p_{0.2}} \geq 345 \text{ MPa}$, $A \geq 40\%$, 硬度 HRC ≤ 25 , 927°C / 62MPa 持久寿命 $\tau \geq 36\text{h}$, $A \geq 10\%$; (2) GH4061: 合金棒材-196°C 拉伸性能: $R_m \geq 1500 \text{ MPa}$, $A \geq 12\%$, 室温拉伸性能 $R_m \geq 1300 \text{ MPa}$, $A \geq 20\%$, 650°C 拉伸性能 $R_m \geq 1000 \text{ MPa}$, $A \geq 12\%$, 750°C 拉伸性能 $R_m \geq 670 \text{ MPa}$, $A \geq 8\%$; 750°C / 100MPa 持久寿命 $\tau \geq 1\text{h}$ 。
79	原位自生陶瓷颗粒铝基复合材料	(1) 高强度铸造陶铝材料: 抗拉强度 $\geq 410 \text{ MPa}$, 弹性模量 $\geq 85 \text{ GPa}$, 延伸率 $\geq 2\%$; (2) 高模量铸造陶铝材料: 抗拉强度 $\geq 360 \text{ MPa}$, 弹性模量 $\geq 90 \text{ GPa}$, 延伸率 $\geq 0.5\%$; (3) 高塑性铸造陶铝材料: 抗拉强度 $\geq 350 \text{ MPa}$, 弹性模量 $\geq 73 \text{ GPa}$, 延伸率 $\geq 14\%$; (4) 超高强变形陶铝材料: 抗拉强度 $\geq 805 \text{ MPa}$, 弹性模量 $\geq 76 \text{ GPa}$, 延伸率 $\geq 8\%$; (5) 高抗疲劳变形陶铝材料: 抗拉强度 $\geq 610 \text{ MPa}$, 弹性模量 $\geq 83 \text{ GPa}$, 延伸率 $\geq 6\%$ 。
80	高强轻质铝锂合金和含钪铝合金	(1) 2195 合金板材: 厚度 1-80mm, L-T 向抗拉强度 $\geq 560 \text{ MPa}$, 屈服强度 $\geq 500 \text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 6\%$; (2) 2050 合金厚板: 厚度 25-152mm, L 向抗拉强度 $\geq 490 \text{ MPa}$, 屈服强度 $\geq 455 \text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 5\%$, 断裂韧度 K_{Ic} (L-T 向) $\geq 28 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$; (3) 2195 合金环件: 直径 3-8m, 纵向抗拉 $\geq 520 \text{ MPa}$, 屈服强度 $\geq 460 \text{ MPa}$, 延伸率 $\geq 5\%$; (4) 含 Sc 铝合金加工材: 典型热处理状态抗拉强度级别 360MPa 以上, 接头焊接系数 $\geq 85\%$ 。

序号	材料名称	性能要求
81	精密钛合金铸件	(1) 薄壁复杂结构精密钛合金铸件：牌号 ZTC4、ZTA15，室温下抗拉强度 $\geq 890\text{ MPa}$ ，屈服强度 $\geq 820\text{ MPa}$ ，铸件最大尺寸 $\geq \Phi 1800\text{ mm}$ ，最小壁厚 $\leq 3\text{ mm}$ ，重量 $\geq 500\text{ kg}$ ，表面粗糙度 R_a 范围 $3.2\text{--}6.3\text{ }\mu\text{m}$ ，尺寸精度 CT5-CT7 级； (2) 大型薄壁复杂结构精密耐高温钛合金铸件：铸件室温下抗拉强度 $\geq 930\text{ MPa}$ ，屈服强度 $\geq 820\text{ MPa}$ ，延伸率 $\geq 10\%$ ；500°C 高温下抗拉强度 $\geq 630\text{ MPa}$ ，屈服强度 $\geq 500\text{ MPa}$ ，延伸率 $\geq 12\%$ ；550°C 高温下抗拉强度 $\geq 540\text{ MPa}$ ，屈服强度 $\geq 450\text{ MPa}$ ，延伸率 $\geq 15\%$ ；铸件最大尺寸 $\geq 1500\text{ mm}$ ，最小壁厚 $\leq 3\text{ mm}$ ，重量 $\geq 70\text{ kg}$ ，表面粗糙度 R_a 范围 $3.2\text{--}6.3\text{ }\mu\text{m}$ ，尺寸精度 CT6-CT7 级； (3) 高承压极端复杂流道耐低温钛合金铸件：铸件室温下抗拉强度 $\geq 740\text{ MPa}$ ，屈服强度 $\geq 660\text{ MPa}$ ，延伸率 $\geq 9\%$ ；-253°C 下抗拉强度 $\geq 1350\text{ MPa}$ ，延伸率 $\geq 11\%$ ；铸件最小壁厚 $\leq 3\text{ mm}$ ，表面粗糙度 $3.2\text{--}6.3\text{ }\mu\text{m}$ ，尺寸精度 CT6-CT7 级，打水压 67 MPa 下保压 15 min 不渗漏。
82	高强损伤容限性钛合金	(1) 抗拉强度 $\geq 1050\text{ MPa}$ ，延伸率 $\geq 10\%$ ，冲击韧性 $\geq 40\text{ J/cm}^2$ ，断裂韧性 $K_{Ic} \geq 80\text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ ，室温轴向加载疲劳极限 $\geq 500\text{ MPa}$ ($N=10^7$, $K_t=1$, $R=0.06$, $f=130\text{--}135\text{ Hz}$)； (2) 抗拉强度 $\geq 1000\text{ MPa}$ ，延伸率 $A \geq 7\%$ ，冲击韧性 $\geq 40\text{ J/cm}^2$ ，断裂韧性 $K_{Ic} \geq 80\text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ ，室温轴向加载疲劳极限 $\geq 400\text{ MPa}$ ($N=10^7$, $K_t=1$, $R=0.06$, $f=130\text{--}135\text{ Hz}$)，500°C/470MPa 条件下高温持久性能 $t \geq 50\text{ h}$ 。
83	铝基碳化硅复合材料	室温热导率 $\geq 200\text{ W/(m\cdot K)}$ ，抗弯折强度 $\geq 500\text{ MPa}$ ，热膨胀系数 (RT-200°C) $< 9\text{ ppm}/\text{^\circ C}$ 。
84	高性能航空航天石墨密封材料及制品	抗压强度 $\geq 140\text{ MPa}$ ，抗折强度 $\geq 60\text{ MPa}$ ，肖氏硬度 75-95Hs，石墨化度 $\geq 85\%$ ，摩擦系数 ≤ 0.15 ，开口气孔率 $\leq 2\%$ ，热失重 $\leq 5\%$ (650°C, 50h)，颗粒度 $\leq 10\text{ }\mu\text{m}$ ，导热系数 $\geq 60\text{ W/(m\cdot K)}$ (400°C)，泊松比 0.23-0.25，热膨胀系数 $\leq 5 \times 10^{-6}/\text{^\circ C}$ ，体积密度 $\geq 1.95\text{ g/cm}^3$ 。
85	高性能碳纤维预浸料	0° 拉伸强度 $\geq 2500\text{ MPa}$ ，0° 拉伸模量 $\geq 155\text{ GPa}$ ，CAI $\geq 285\text{ MPa}$ 。
86	高硅氧玻璃纤维制品	SiO ₂ 含量 $\geq 96\%$ ，使用耐温 1000°C，瞬间耐温 1600°C。

序号	材料名称	性能要求
87	碳纤维/环氧树脂复合材料	层间剪切强度 > 70MPa, 弯曲强度 > 1200MPa, 拉伸强度 > 1800MPa。
88	航空制动用碳/碳复合材料	密度 $\geq 1.80\text{g/cm}^3$, 抗压强度 $\geq 140\text{MPa}$, 抗弯强度 $\geq 120\text{MPa}$, 层间剪切强度 $\geq 12\text{MPa}$, 高能刹车(能流密度 $\geq 3000\text{kW/m}^2$, 面积能载 $\geq 60\text{MJ/m}^2$), 摩擦系数 ≥ 0.15 。
89	超高温碳/陶复合材料及制品	密度 $\geq 1.85\text{g/cm}^3$, 拉伸模量 $\geq 80\text{GPa}$, 断裂韧性 $\geq 15\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$, 1300°C 拉伸强度 $\geq 200\text{MPa}$, 1300°C 抗弯强度 $\geq 300\text{MPa}$, 1300°C 面内剪切强度 $\geq 100\text{MPa}$, 导热系数 $\geq 15\text{W/m}\cdot\text{K}$, 热膨胀系数 (25°C-1300°C): 1.0×10^{-6} - $4.5 \times 10^{-6}/\text{°C}$ 。
90	高性能碳纤维增强陶瓷基摩擦材料	密度 $\leq 2.4\text{g/cm}^3$, 使用温度 50-1650°C, 抗压强度 $\geq 160\text{MPa}$, 抗弯强度 $\geq 120\text{MPa}$, 摩擦系数 0.2-0.45, 摩擦系数热衰退率 $\leq 15\%$ 。
91	EBPVD 热障涂层 用 YSZ 陶瓷靶材	A1、Ca、Cr、Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na、Ni、V、Si、Ti、Cl 杂质总量 $< 0.05\text{wt\%}$, Y_2O_3 含量 7-9wt%, HfO_2 含量 $< 2\text{wt\%}$, 密度 $3.7\text{-}4.8\text{g/cm}^3$, 物相为四方相和单斜相, 闭合气孔率 $< 5\%$ 。
92	航空发动机高温合金叶片与叶盘材料	(1) 航空发动机用 DD407 单晶高温合金叶片: 叶型公差 $\pm 0.05\text{mm}$; 760°C 拉伸性能: $\text{R}_m \geq 980\text{MPa}$, $\text{R}_{p_{0.2}} \geq 900\text{MPa}$, $A \geq 4\%$; 持久性能: 760°C/780MPa, $\tau \geq 250\text{h}$; 850°C/500MPa, $\tau \geq 260\text{h}$; 950°C/240MPa, $\tau \geq 260\text{h}$; 1050°C/140MPa, $\tau \geq 180\text{h}$; (2) 粉末/铸造高温合金双合金整体叶盘: 盘体 760°C 拉伸性能: $\text{R}_m \geq 960\text{MPa}$, $\text{R}_{p_{0.2}} \geq 720\text{MPa}$, $A \geq 15\%$, $Z \geq 18\%$; 盘体 760°C/586MPa 持久性能: $\tau \geq 15\text{h}$, $A \geq 8\%$; 连接部位 540°C 拉伸性能: $\text{R}_m \geq 760\text{MPa}$, 不断于连接界面; 叶片环 760°C/530MPa 持久性能: $\tau \geq 50\text{h}$, $A \geq 2\%$ 。
四	新型能源材料	
93	耐磨耐腐蚀双金属复合材料	(1) 热等静压工艺制备钴基合金覆层: 密度 $\geq 8.0\text{g/cm}^3$, 硬度 $\geq 41\text{HRC}$, 抗拉强度 $\geq 1000\text{MPa}$; 界面结合强度 $\geq 260\text{MPa}$; 基材热等静压后抗拉强度 $\geq 485\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 175\text{MPa}$; (2) 热等静压工艺制备镍基合金覆层: Co 含量 (wt) $\leq 0.05\%$, 抗拉强度 $\geq 1000\text{MPa}$, 抗压强度 $\geq 700\text{MPa}$; 界面结合强度 $\geq 260\text{MPa}$; 基材热等静压后抗拉强度 $\geq 485\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 175\text{MPa}$ 。

序号	材料名称	性能要求
94	燃料电池全氟质子膜	质子传导率 $\geq 0.08\text{S}/\text{cm}$ (GB/T20042.3-2009) , 尺寸稳定性 (溶胀率, 各向) $\leq 7\%$ (GB/T20042.3-2009) , 电化学稳定性 (1000h) 渗氢电流 $\leq 10\text{mA}/\text{cm}^2$ (GB/T20042.3-2009) , 复合膜厚度偏差 $\leq \pm 2\mu\text{m}$ (GB/T20042)。
95	反应堆中子吸收体材料	Ag 含量 $80 \pm 0.50\text{wt\%}$, In 含量 $15 \pm 0.25\text{wt\%}$, Cd 含量 $5 \pm 0.25\text{wt\%}$, 杂质总量 $\leq 0.25\text{wt\%}$, 晶粒度 4-6 级, 试样经 $350^\circ\text{C}/10\text{h}$ 处理后, > 3 级的晶粒比例 $< 30\%$ 。
96	储氢气瓶用碳纤维复合材料	(1) 车船用燃料电池氢气瓶: 工作压力 $\geq 35\text{MPa}$, 使用寿命 10-15 年, 质量储氢密度 4.0%; (2) 无人机用燃料电池氢气瓶: 工作压力 35MPa , 使用寿命 5 年, 质量储氢密度 7.0%。
97	氢能源燃料电池用柔性石墨双极板	密度 $> 1.9\text{g}/\text{cm}^3$, 电导率 $> 100\text{S}/\text{m}$, 抗压强度 $> 100\text{MPa}$, 腐蚀电流 $< 0.016\text{mA}/\text{cm}^2$, 热传导系数 $> 10\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 抗弯强度 $> 50\text{MPa}$, 透气率 $< 2 \times 10^{-6}\text{cm}^3/\text{s}\text{cm}^2$ 。
98	燃料电池催化剂	铂碳或铂合金催化剂, Pt 晶粒尺寸 $2.5\text{-}4.5\text{nm}$ (XRD 法), 氧还原反应质量活性 $\geq 0.28\text{A}/\text{mg}\cdot\text{Pt}$ 。
99	燃料电池汽车用高纯氢气	氢气纯度 $\geq 99.99\%$, 水 (H_2O) $\leq 2\mu\text{mol}/\text{mol}$, 氧 (O_2) $\leq 2\mu\text{mol}/\text{mol}$, 总烃 (按甲烷计) $\leq 1\mu\text{mol}/\text{mol}$, 二氧化碳 (CO_2) $\leq 1\mu\text{mol}/\text{mol}$, 一氧化碳 (CO) $\leq 0.1\text{mol}/\text{mol}$, 总氮 (N_2) $\leq 50\mu\text{mol}/\text{mol}$ 。
100	燃料电池用钛基气体扩散层材料	材料性能指标: 材质: 钛 (TA2), 孔隙度大于 45%, 渗透率 $\geq 1.5 \times 10^{-4}\text{/Pa}\cdot\text{min}\cdot\text{cm}^2$; 使用性能指标: 格雷系数 $4.5\text{s}-8.5\text{s}$ 。
101	三元材料 (镍钴铝酸锂、镍钴锰酸锂)	比容量 $\geq 200\text{mAh/g}$ (0.5C), 循环寿命 ≥ 1000 周 (80%, 0.5C)。
102	三元材料前驱体	(1) 偏比例小颗粒高镍 NCA 材料: 主含量 Ni: 80-95mol%, Co: 0-15mol%, Al: 0-5mol%; 主要杂质含量: Na $\leq 80\text{ppm}$, S $\leq 2500\text{ppm}$, M. I. $\leq 50\text{ppb}$; 粒径 D50: 3-6 μm ; 比表面积 BET: $20\text{-}40\text{m}^2/\text{g}$; 振实密度 TD $\geq 1.4\text{g}/\text{cm}^3$; (2) 偏比例超高镍 NCA 材料: 主含量 Ni: 90-95mol%, Co: 0-5mol%, Al: 0-5mol%, 主要杂质含量: Na $\leq 80\text{ppm}$, S $\leq 2000\text{ppm}$, M. I. $\leq 50\text{ppb}$; 粒径 D50: 10-17 μm ; 比表面积 BET: $8\text{-}20\text{m}^2/\text{g}$; 振实密度 TD $\geq 1.8\text{g}/\text{cm}^3$; (3) 偏比例 NCM 前驱体材料: 主含量 Ni: 80-95mol%; Co: 0-10mol%; Mn: 5-20mol%; 主要杂质含量

序号	材料名称	性能要求
		Na ≤ 200ppm, S ≤ 2000ppm, M. I. ≤ 60ppb; 粒径 D50: 9–12 μm; 比表面积 BET4–8m ² /g; 振实密度 TD ≥ 2.0g/cm ³ ; (4) 单颗粒 NCM 前驱体材料: Ni: 80–95mol%; Co: 0–10mol%; Mn: 5–20mol%; 主要杂质含量 Na ≤ 200ppm, S ≤ 1500ppm, M. I. ≤ 60ppb; 粒径 D50: 3–5 μm; 比表面积 BET8–24m ² /g; 振实密度 TD ≥ 1.2g/cm ³ 。
103	核用低氧低碳 TZM	室温: Rm ≥ 680MPa, Rp _{0.2} ≥ 585MPa, A ≥ 14%; E ≥ 295GPa; 1200°C: Rm ≥ 215MPa, A ≥ 13%, E ≥ 265GPa; 氧含量 ≤ 300ppm。
五	其它材料	
104	高铁制动用高性能铜基复合材料	密度标称值 × (1+0.1), 硬度 [HBW/10/250/30] 10–30, 摩擦体剪切强度 ≥ 6MPa。
105	VOCs 回收膜	膜元件 (8040 标准型), 膜两侧二氧化碳浓度差 ≥ 9%, 渗透通量 ≥ 4.6Nm ³ /h, 膜元件静电防爆耐腐蚀, 测试标准 (测试气体为 CO ₂ /N ₂ 混合气体, 进气 CO ₂ 含量 8% ± 0.5%, 进气量为 18Nm ³ /h, 进气温度 25°C, 操作压力为常压, 真空度 9000Pa)。
106	高性能微晶玻璃	(1) 零膨胀微晶玻璃: 膨胀系数为 0 ± 0.02 × 10 ⁻⁶ /°C, 热胀系数均匀性 ≤ ± 0.01 × 10 ⁻⁶ /°C, 5mm 厚样品 632.5nm 透过率 ≥ 85%; (2) 5G 通讯用微晶玻璃: 透过率 (t=0.68mm, λ=550nm) ≥ 91%, 热传导率 (25°C) ≥ 1.5W/(m · K), 维氏硬度 Hv0.2/20–强化 ≥ 790 × 10 ⁷ Pa, 化学稳定性(损失量) (5%HCl, 95°C, 24h) ≤ 0.1mg/cm ² , (5%NaOH, 95°C, 6h) ≤ 0.2mg/cm ² , 跌落测试破摔高度: ≥ 2000mm (测试条件: t=0.68mm, 测试面: 80 目砂纸, SiC 颗粒; 40g 负重, 测试总重 60g)。
107	高性能电磁屏蔽玻璃	电磁屏蔽效能: ≥ 25dB (150KHz–18GHz), 透光率 ≥ 70%。
108	喷射成型耐高温耐腐蚀陶瓷涂层	耐温 1200°C, 硬度 HV1100, 结合强度 45MPa, 耐强酸强碱。

序号	材料名称	性能要求
109	高精度超硬金刚石材料	<p>(1) 高精度 CMP 抛光垫修整砂轮：金刚石间距 $300\text{--}500\mu\text{m}$, 金刚石突出比例 20%-40%, 金刚石平整度 $< 100\mu\text{m}$, Disk 金刚石漏布比例 $< 0.5\%$, Disk 掉钻 0;</p> <p>(2) 金刚石划片刀：厚度 $10\text{--}200\mu\text{m} \pm 2.5\mu\text{m}$, 内孔尺寸 $19.050\text{--}19.055\text{mm}$, 刀痕宽度 $12.5\text{--}200\mu\text{m} \pm 2.5\mu\text{m}$, 刀刃长度 $250\text{--}2000\mu\text{m} \pm 65\mu\text{m}$, 外圆和内孔同心度 $< 20\mu\text{m}$, 刀片外径 $55.610\text{mm} \pm 20\mu\text{m}$;</p> <p>(3) 精密加工用金刚石微粉：1.M6/12: (6-12) 微米含量 $> 95\%$, 最大颗粒直径 ≤ 15 微米, 杂质含量 $\leq 1\%$, 针棒状 $\leq 2\%$; 2.M40/60: (40-60) 微米含量 $> 95\%$, 最大颗粒直径 ≤ 72 微米, 杂质含量 $\leq 1\%$, 针棒状 $\leq 2\%$;</p> <p>(4) 先进金刚石复合材料及制品：工作齿焊接抗弯强度 $\geq 650\text{MPa}$, 洛氏硬度 HRB ≥ 80。</p>
110	高性能陶瓷基复合材料	<p>(1) 耐烧蚀 C/SiC 复合材料：密度为 $2.5\text{--}3.2\text{g/cm}^3$, 室温拉伸强度 $\geq 150\text{MPa}$, 拉伸模量 $\geq 120\text{GPa}$, 断裂韧性 $\geq 10\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$, 1600°C 拉伸强度 $\geq 100\text{MPa}$, 耐温性能 $\geq 1800^\circ\text{C}$, 满足 2MW/m^2 以上热流环境下 1000s 零烧蚀或微烧蚀的要求;</p> <p>(2) 高温透波陶瓷基复合材料：拉伸强度 $> 30\text{MPa}$, 弯曲强度 $> 50\text{MPa}$, 压缩强度 $> 60\text{MPa}$, 比热容 $\geq 0.8\text{KJ/(kg}\cdot\text{K)}$, 热导率 $\leq 1\text{W/(m}\cdot\text{K)}$, 线胀系数 $\leq 0.6 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, 介电常数 $2.7\text{--}3.2$, 线烧蚀速率 $\leq 0.2\text{mm/s}$;</p> <p>(3) 核用电 SiC/SiC 复合材料：密度为 $2.7\text{--}2.9\text{g/cm}^3$, 室温拉伸强度 $\geq 250\text{MPa}$, 拉伸模量 $\geq 150\text{GPa}$, 断裂韧性 $\geq 10\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$, 1200°C 拉伸强度 $\geq 200\text{MPa}$, 导热系数 $\geq 20\text{W/(m}\cdot\text{K)}$, 热膨胀系数 ($25^\circ\text{C}$-$1300^\circ\text{C}$) $3\text{--}5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$;</p> <p>(4) 航空用 SiC/SiC 复合材料：密度为 $2.5\text{--}2.9\text{g/cm}^3$, 室温拉伸强度 $\geq 250\text{MPa}$, 拉伸模量 $\geq 150\text{GPa}$, 断裂韧性 $\geq 10\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$, 1300°C 拉伸强度 $\geq 200\text{MPa}$, 拉伸模量 $\geq 100\text{GPa}$, 断裂韧性 $\geq 10\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$, 强度保持率 $\geq 80\%$ (1300°C、120MPa 应力下氧气环境热处理 500 小时)。</p>
111	稀土卤化物闪烁晶体	<p>(1) 溴化镧闪烁晶体：块状晶体尺寸 $\geq \Phi 50 \times 50\text{mm}^3$, 衰减时间 $\leq 20\text{ns}$, 能量分辨 $\Delta E/E \leq 3.5\%$, 时间分辨 $\leq 300\text{ps}$, 阵列式晶体探测器衰减时间 $\leq 35\text{ns}$, 峰谷比 ≥ 6.5, 能量分辨优于 $13\% @ 511\text{KeV}$;</p> <p>(2) 溴化铈闪烁晶体：块状晶体尺寸 $\geq \Phi 50 \times 50\text{mm}^3$; 相对光输出 $\geq 140\%$; 闪烁衰减时间 $\leq 20\text{ns}$; 本底计数率 $\leq 0.2\text{cps/cm}^3$; 时间分辨率 $\leq 150\text{ps}$。</p>

序号	材料名称	性能要求
112	超高纯金属电积板和锭材	(1) 超高纯镍、钴电积板: 化学纯度≥99.9999%, 气体元素C、N、H、S、O含量≤5ppm; (2) 超高纯铜电解板: 化学纯度≥99.99999%, 气体元素C、N、H、S、O含量≤5ppm; (3) 镍锭: 化学纯度≥99.999%, 气体元素C、O含量≤20ppm, N、H含量≤10ppm, S≤5ppm; (4) 钴锭: 化学纯度≥99.999%, 气体元素C、N、H、S、O含量≤20ppm, 铸锭内部缺陷率≤0.3%; (5) 铜锭: 化学纯度≥99.9999%, 气体元素C、N、H、S、O含量≤5ppm, 铸锭内部缺陷率≤0.3%; (6) 镍条、镍粒: 化学纯度≥99.99%, C≤15ppm, O≤300ppm, H≤15ppm; (7) 锌锭: 化学纯度≥99.999%, 气体元素C、N、H、O含量≤10ppm, S≤5ppm。
113	高性能钕铁硼永磁体	(1) 48EH 档产品: Br≥13.6kGs, Hcj≥30kOe; (2) 50UH 档产品: Br≥13.9kGs, Hcj≥25kOe; (3) 54SH 档产品: Br≥14.3kGs, Hcj≥20kOe。
114	稀有金属涂层材料	(1) 高温合金稀有金属防护涂层材料: O含量≤300ppm, 涂层在900℃完全抗氧化, 并具备良好的抗热疲劳性能; (2) 复式碳化钨基稀有金属陶瓷涂层材料: 平均显微硬度≥1100HV0.3, 使用温度-140-500℃; (3) 高耐蚀耐磨涂层材料: 结合强度≥70MPa, 硬度HRC30-45, 孔隙率<0.5%, 抗中性盐雾腐蚀≥500小时; (4) 多组元MCrAlY涂层材料: O、N、C、S含量总和≤500ppm, 结合强度≥50MPa, 1050℃水淬≥50次, 1050℃×200h涂层与基体结合及涂层、基体完好无损; (5) 高隔热涂层材料YSZ复相陶瓷材料: 熔点>2000K, 1200℃(100h)无相变, 热导率<1.2W/m·K; (6) 可磨耗封严涂层材料: 使用温度室温-1200℃, 涂层硬度40-90HR15Y, 结合强度≥4MPa, 工况温度下300-450m/s对磨涂层无脱落; (7) 冷喷涂超细合金粉末涂层材料: 粉末粒度D90≤16μm, 振实密度≥4.0g/cm ³ , 近球形粉末形貌; (8) 减摩润滑涂层材料: 涂层使用温度室温-500℃; 涂层干摩擦系数≤0.8; 硬度≤100HB。
115	长波红外金属化窗片	8-12 μm平均透过率≥95%, 13-14 μm平均透过率≥88%, 1-7 μm截止, 耐高温350℃/30min。

序号	材料名称	性能要求
116	声表面波级钽酸锂晶片	居里温度 $603^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 晶片取向 42° Y-X 定向精度 $\pm 0.3^{\circ}$, 晶片直径 $149.95 \pm 0.15\text{mm}$, 晶片厚度 $0.350 \pm 0.020\text{mm}$, OF 定向+X 面 $0^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$, OF 尺寸 $47 \pm 1\text{mm}$, SF 定向: C.C.W $45^{\circ} \pm 2^{\circ}$, SF 尺寸: $12 \pm 2\text{mm}$, 两面抛光 $\text{Ra} \leq 1\text{nm}$, TTV $\leq 7\text{ }\mu\text{m}$, LTV $\leq 1\text{ }\mu\text{m}$ ($5 \times 5\text{mm}$), PLTV $\geq 95\%$ (LTV $\leq 1\text{ }\mu\text{m}$ within $5 \times 5\text{mm}$), WARP $\leq 20\text{ }\mu\text{m}$ 。
117	超高强度焊接材料	抗拉强度 $R_m \geq 880\text{MPa}$; 屈服强度 $R_{p_{0.2}} \geq 790\text{MPa}$; -40°C 冲击吸收能量值 (AKv) $> 47\text{J}$ 。
前沿新材料		
118	石墨烯导电浆料	固含量 $\geq 4\%$, 水分含量 $\leq 1000\text{ppm}$, 粘度 $\leq 30000\text{mPa}\cdot\text{s}$, 涂膜电阻率 $\leq 100\text{m}\Omega\cdot\text{cm}$ 。
119	石墨烯散热材料	(1) 石墨烯散热材料: xy 轴热传导系数 $\geq 1950\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, z 轴热传导系数 $\geq 22\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 辐射系数 $\geq 92\%$, 膜厚 $25\text{--}500\text{ }\mu\text{m}$; (2) 散热涂层: 附着力 0 级, 热辐射率 $\geq 95\%$, 平面热导系数 $\geq 100\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 耐中性盐雾性能 $> 5000\text{h}$, 耐温 $\geq 200^{\circ}\text{C}$, 硬度 $\geq 2\text{H}$ 。
120	涂布法制备石墨烯电热膜	PET、云母或 PI 封装, 工作电压 $110\text{--}220\text{V}$, 功率密度 $160\text{--}260\text{W/m}^2$, 表面工作温度 $45\text{--}100^{\circ}\text{C}$, 使用寿命 > 30000 小时, 电热转化效率 $> 98\%$, 电热辐射转化效率 $> 70\%$, 可有效发射 $4\text{--}14\text{ }\mu\text{m}$ 波长远红外线, 温度不均匀性 $< 10\%$ 。
121	石墨烯改性润滑材料	(1) 石墨烯齿轮油: 采用 SH/T0189 方法, 条件 $1800\text{r/min}, 196\text{nN}, 60\text{min}, 54^{\circ}\text{C}$ 下测试, 磨斑直径 $\leq 0.32\text{mm}$; PD $\geq 3000\text{N}$; FZG 台架测试不低于 11 级; (2) 石墨烯抗磨液压油: FZG 台架测试不低于 9 级; 摩擦系数 < 0.11 ; 氧化安定性 $> 3000\text{h}$ 。
122	气凝胶绝热毡	导热系数: $\leq 0.021\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ (常温 25°C), $\leq 0.036\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ (300°C), $\leq 0.072\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ (500°C); A2 级防火; 压缩回弹率 $\geq 90\%$; 震动质量损失率 $\leq 1.0\%$; 符合 GB/T34336 中 A 类产品要求。

序号	材料名称	性能要求
123	3D 打印用合金粉末	(1) 钛合金粉末：粒度范围 $15\text{--}200 \mu\text{m}$, 球形度 $\geq 94\%$, 氧含量 $< 100\text{ppm}$, 霍尔流速 $< 30\text{s}/50\text{g}$, 空心粉 $\leq 0.8\%$, 非金属夹杂个数 $< 10 \text{ 个/kg}$, 松装密度 $\geq 50\%$; (2) 高温合金粉末：粒度范围 $15\text{--}150 \mu\text{m}$, 球形度 $\geq 98\%$, 氧含量 $< 50\text{ppm}$, 霍尔流速 $< 14\text{s}/50\text{g}$, 空心粉 $\leq 0.8\%$, 非金属夹杂个数 $< 10 \text{ 个/kg}$; (3) 高温钛合金粉末：粒度范围 $15\text{--}53 \mu\text{m}$, 球形度 $\geq 95\%$, 氧含量 $< 200\text{ppm}$, 霍尔流速 $< 35\text{s}/50\text{g}$, 空心粉 $\leq 0.5\%$, 松装密度 $\geq 50\%$; (4) 纯钽金属粉末：粒度范围 $15\text{--}250 \mu\text{m}$, 球形度 $\geq 90\%$, 氧含量 $\leq 1500\text{ppm}$, 霍尔流速 $\leq 15\text{s}/50\text{g}$; (5) 3D 打印用高流动性铝合金粉末：粒度范围 $15\text{--}54 \mu\text{m}$, $15\text{--}45 \mu\text{m}$, 球形度 $\geq 97\%$, 氧含量 $\leq 500\text{ppm}$, 霍尔流速 $\leq 40\text{s}/50\text{g}$, 空心球率 $\leq 3\%$ 。
124	粉末冶金超高性能特种合金	(1) 粉末冶金高性能耐磨耐腐蚀材料：室温抗弯强度 $> 3000\text{MPa}$; 硬度 $> \text{HRC}58$, 无缺口夏比冲击功 $> 20\text{J/cm}^2$; 耐磨性是 M2 高速钢的 1.5 倍以上; 在 1% 盐酸水溶液中的耐腐蚀性是 M2 高速钢的 10 倍以上。在磨损环境下实际使用寿命是 M2 高速钢的 2 倍以上; 盐雾试验 48h 无锈蚀, 硬质相体积分数 $> 10\%$, 硬质相平均尺寸 $< 5 \mu\text{m}$; 在典型的磨损、腐蚀耦合使用环境下, 使用寿命是 M2 高速钢的 10 倍以上, 是马氏体不锈钢 9Cr18MoV 的 5 倍以上; (2) 粉末冶金制备超高温铁铬铝电热合金：电阻率 $1.38\text{--}1.45 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$; 室温抗拉强度 $\geq 700\text{MPa}$; 1000°C 抗拉强度 $\geq 30\text{MPa}$; 1350°C 快速寿命实验性能 $\geq 70\text{h}$ 。
125	实用化超导材料	(1) 高场 Nb3Sn 超导线材：单根千米级线材临界电流密度达到 3000A/mm^2 ($4.2\text{K}, 12\text{T}$) ; (2) Bi2223 带材：长度达到 1000 米, 临界电流达到 200A; (3) Bi2212 线材：长度 > 500 米, 临界电流密度 $> 2000\text{A/mm}^2$ ($4.2\text{K}, 14\text{T}$) ; (4) MgB2 线材：长度 > 3000 米, 临界电流密度 $> 1 \times 10^5 \text{A/cm}^2$ ($20\text{K}, 3\text{T}$) 。
126	注射成型用钛合金粉末	(1) TA1: 粒径 $\leq 45 \mu\text{m}$, 流动性 $\leq 38\text{s}/50\text{g}$, 中位径 $D_{50} \leq 45 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 氧含量 $\leq 0.10\%$; (2) TC4: 粒径 $\leq 45 \mu\text{m}$, 流动性 $\leq 38\text{s}/50\text{g}$, 中位径 $D_{50} \leq 45 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 氧含量 $\leq 0.10\%$; (3) TA15: 粒径 $\leq 45 \mu\text{m}$, 流动性 $\leq 38\text{s}/50\text{g}$, 中位径 $D_{50} \leq 45 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 氧含量 $\leq 0.10\%$ 。

序号	材料名称	性能要求
127	热等静压用高性能钛合金粉末	(1) TA1: 粒径 45–240 μm , 流动性 $\leq 30\text{s}/50\text{g}$, 中位径 $D_{50} \leq 240 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 氧含量 $\leq 0.08\%$, 球形度 $\geq 96\%$; (2) TC4: 粒径 45–240 μm , 流动性 $\leq 30\text{s}/50\text{g}$, 中位径 $D_{50} \leq 240 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 氧含量 $\leq 0.08\%$, 球形度 $\geq 96\%$; (3) TA15: 粒径 45–240 μm , 流动性 $\leq 30\text{s}/50\text{g}$, 中位径 $D_{50} \leq 240 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 氧含量 $\leq 0.08\%$, 球形度 $\geq 96\%$; (4) TiAl: 粒径 45–240 μm , 流动性 $\leq 30\text{s}/50\text{g}$, 中位径 $D_{50} \leq 240 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 氧含量 $\leq 0.08\%$, 球形度 $\geq 96\%$ 。
128	NiCrBSi 系自熔性合金粉末	(1) 氧乙炔喷焊、等离子熔覆激光熔覆粒度分布: 45–106 μm , 球形度 $\geq 90\%$, 流动性 $\leq 16.5\text{s}/50\text{g}$, 松装密度 $\geq 4.5\text{g}/\text{cm}^3$, 氧含量 $\leq 300\text{ppm}$; (2) 超音速火焰喷涂粒度分布: 15–53 μm , 球形度 $\geq 95\%$, 流动性 $\leq 17.5\text{s}/50\text{g}$, 松装密度 $\geq 4.5\text{g}/\text{cm}^3$, 氧含量 $\leq 300\text{ppm}$ 。
129	电子封装用高性能锡焊粉	(1) 焊粉粒度分布至少 90% 的颗粒尺寸在 15–25 μm ; 少于 1% 的颗粒尺寸 $> 25 \mu\text{m}$, 且没有 30 μm 以上颗粒; 最多 10% 的颗粒尺寸 $< 15 \mu\text{m}$; 形貌上 90% 以上的焊锡粉是球形的和长短轴比 < 1.2 的近球形; 氧含量 $< 0.018\text{wt\%}$; (2) 焊粉粒度分布至少 90% 的颗粒尺寸在 5–15 μm ; 少于 1% 的颗粒尺寸 $> 15 \mu\text{m}$, 且没有 20 μm 以上颗粒; 最多 10% 的颗粒尺寸 $< 5 \mu\text{m}$; 形貌上 90% 以上的焊锡粉是球形的和长短轴比 < 1.2 的近球形; 氧含量 $< 0.020\text{wt\%}$ 。
130	舵机用 3D 打印钛合金壳体	壳体室温抗拉强度 $\geq 895\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 825\text{MPa}$, 延伸率 $\geq 10\%$; 400°C 高温抗拉强度 $\geq 620\text{MPa}$, 屈服强度 $\geq 570\text{MPa}$, 延伸率 $\geq 12\%$; 冶金质量满足 GJB2896A 规定 I 类 B 级铸件要求。
131	高性能球形非晶、纳米晶粉末	(1) 高性能球形非晶粉末: 激光粒度 $D_{50} 15–30 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 流动性 $\leq 20\text{s}/50\text{g}$, 氧含量 $\leq 600\text{ppm}$, 球形度 $\geq 90\%$; (2) 高性能球形纳米晶粉末: 激光粒度 $D_{50} 15–25 \mu\text{m}$, 松装密度 $\geq 50\%$ 理论密度, 流动性 $\leq 25\text{s}/50\text{g}$, 氧含量 $\leq 1500\text{ppm}$, 球形度 $\geq 90\%$ 。